

## 导热预固化硅凝胶 RH-TCG-6220

### 特色:

- 单组分导热预固化硅凝胶
- 低硬度, 低模量, 低应力
- 加成体系, 耐高温, 无小分子释放
- 低挥发分, 挥发性环体<300PPM
- 高热稳定性, 耐热冲击循环

### 产品组成

- 硅凝胶
- 无机导热填料

### 产品应用

- 通用性导热凝胶, 如计算芯片, 服务器等。
- 集成电路模块 PCB 导热

### 常见性能参数\*

产品名称	RH-TCG-6220
导热率 (瞬态法) W(m · K)	6.0
单组分	蓝色
密度 g/m	3.2 ± 0.1
介电强度, KV/mm	≥11
体积电阻率 Ω · cm	≥1.0*10 <sup>14</sup>
挤出率 g/min	>42
固化时间 (120 ° C 平板加热) min	10
固化时间 (150 ° C 鼓风干燥箱) min	30
可操作时间 (25 ° C) d	28-30

### 应用方法

- 自动点胶机

### 固化条件

- 完全固化: 加热固化

### 运输储存条件

#### 单组分包装:

- 200L 铁桶包装
- 低于 45 摄氏度运输
- 常温保存, 最佳使用期限为 1 个月以内
- 可根据实际需求定制包装

### 产品应用温度

通常有机硅材料在很大温度范围内保持稳定, 考虑到综合性能和老化影响, 此系列 -25 至 150 摄氏度范围内使用可获得最佳效果。如需其他温度范围, 请咨询应用工程师。



#### 其他注意事项

- 使用表面需保持清洁
- 工艺过程避免接触 N, S, P 等杂质
- 如需返工, 再次使用前需清洁表面
- 点胶和涂胶过程中应避免气泡
- 避免人体皮肤直接接触